

第 9 屆國際構裝研討會 IMPACT-EMAP 2014 論文徵稿開跑

最國際、最專業的技術論文發表平台挑戰全球各路高手，就是現在！

第 9 屆國際構裝暨電路板研討會(簡稱 IMPACT 研討會)論文徵稿熱血開跑！全台最盛大的國際電子零組件、組裝、封測、電路板產業的年度盛會將在 10 月 22 至 24 日於南港展覽館舉辦，今年特別結合第 16 屆國際電子材料封裝研討會(EMAP)共同合辦，同期更可順訪年度最大電路板國際展覽 TPCA Show 2014。呼應當前終端消費電子以人為本的設計趨勢，研討會聚焦「挑戰變革、勾勒未來 Challenge for Change-Shaping the Future」，邀稿活動即日起正式開始，同時，台灣電路板協會 PCB 優秀論文獎同步徵集中，獎金高達十萬元，心動請馬上行動立即投稿。

IMPACT 研討會是一年一度在台舉辦的國際構裝暨電路板技術研討會，不僅是學生教授發表論文的最佳平台，同時是產業界研發部門的年度成果發表會，為串聯大專院校、公司企業及研究機構三方的交流平台。第 9 屆 IMPACT 研討會與第 16 屆 EMAP 國際會議共同舉辦，IMPACT-EMAP 2014 由 IEEE CPMT-Taipei、IMAPS-Taiwan、工研院及台灣電路板協會共同主辦，本研討會受到國際組織 IEEE 和 iMAPS 學會認可，綜合四大特點包括「客觀多樣」美日韓等各國指標趨勢，「多元應用」主題論壇宏觀剖析，「先端專業」深入上游電子電路材料技術，「指標前瞻」掌握下游封裝發展動向。竭誠歡迎國內外業界及學術界先進踴躍投稿，論文摘要截止日期為 6 月 15 日，優秀論文獎和投稿領域詳大會官網 <http://www.impact.org.tw/2014/General/>，或電(03)3815659 分機 405 楊小姐。

【研討會】 IMPACT-EMAP 2014 第 9 屆國際構裝研討會暨第 16 屆國際電子材料封裝研討會

【展覽】 TPCA Show2014 台灣電路板產業國際展覽會

【日期】 2014 年 10 月 22-24 日(三-五)

【地點】 台北南港展覽館

【線上投稿】 <http://www.impact.org.tw>

【投稿重要時程】

- 2014 年 6 月 15 日--論文草稿截止(四百至五百字為限，請線上投稿)
- 2014 年 7 月 14 日--論文草稿核可(以電子郵件寄送通知)
- 2014 年 8 月 15 日--繳交完整論文(包含圖表共四頁，請線上繳交至大會網站)
- 2014 年 10 月 1 日--繳交口試論文發表資料(15 分鐘發表，內含 3 分鐘 Q&A)

【徵文內容概要】

IMPACT

| | |
|---|--|
| Packaging | PCB |
| P1 -Advanced Packaging Technologies | B1. Green Materials and Process |
| P2. Green Packaging | B2. Test, Quality, Inspection and Reliability Technology |
| P3-3D Integration | B3. HDI and Embedded Technology |
| P4-LED & Optoelectronics Packaging | B4. Electro Deposition and Electrochemical Processing Technology |
| P5-Interconnections & Nanotechnology | B5. Advanced and Emerging Technology |
| P6-Modeling, Simulation & Design | B6. Mechatronics and Automation |
| P7-Thermal Management | B7. Marketing & Management |
| P8- Advanced Sensor & Microsystems Technology (MST) | |
| P9-Advanced Materials, Automatic Process & Assembly | |
| P10-Emerging Systems Packaging Technologies | |

EMAP

| | |
|---|--|
| Materials and Packaging | |
| M1. Materials and Processing | M2. Passive and Active Components |
| M3. Optoelectronics / Photonics | M4. Sensor, Actuator, and Transducer Technologies |
| M5. Advanced Packaging | M6. Thru Silicon Via (TSV) Technology |
| M7. Interconnection Technologies | M8. System-in-Package (SiP) and 3D Stacked Die Packaging |
| M9. Electrical Modeling, Characterization, and Signal Integrity | M10. Thermal-Mechanical Modeling and Characterization |
| M11. Quality and Reliability | M12. Packaging Technologies for High Brightness LEDs |
| M13. Flexible Electronics | M14. Others |

* Papers relevant with the above scopes are encouraged to submit but NOT limited to.

* Conference authority keeps the right to final session arrangement.

【聯絡窗口】

台灣電路板協會 (TPCA)

電話: +886 3 381 5659 #405-楊庭芳小姐(Sylvia)

傳真: +886 3 381 5150

E-Mail: service@impact.org.tw

| | | | |
|-------|--|------|------------|
| 發稿單位 | 台灣電路板協會 | 發稿日期 | 2014.02.21 |
| 新聞聯絡人 | 邱筱雯 T:(03)3815659 #406 E: jessie@tpca.org.tw | | |
| 大會秘書處 | 楊庭芳 T:(03)3815659 #405 官網: www.impact.org.tw | | |